ボイドを抑制するソルダペースト

Solder Paste that Suppresses Voids

ボイド発生のメカニズムを解明し、製品設計に活かしました

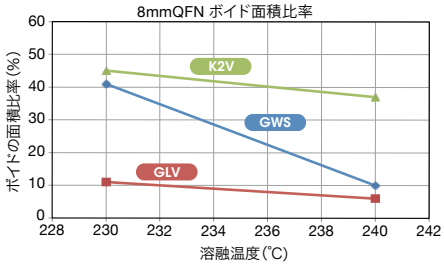
Product Design has Fully Applied Clarified Void Formation Mechanism

特　長

- ボイド発生メカニズムを解明し、独自の有機合成技術でボイドを抑制
- 温度が上がりづらい底面電極部品のボイド抑制に最適
- 濡れ性が高く、酸化しやすい部品や基板のはんだ付けにも最適
- 底面電極部品に加えて、チップ部品にも対応した新製品を開発中

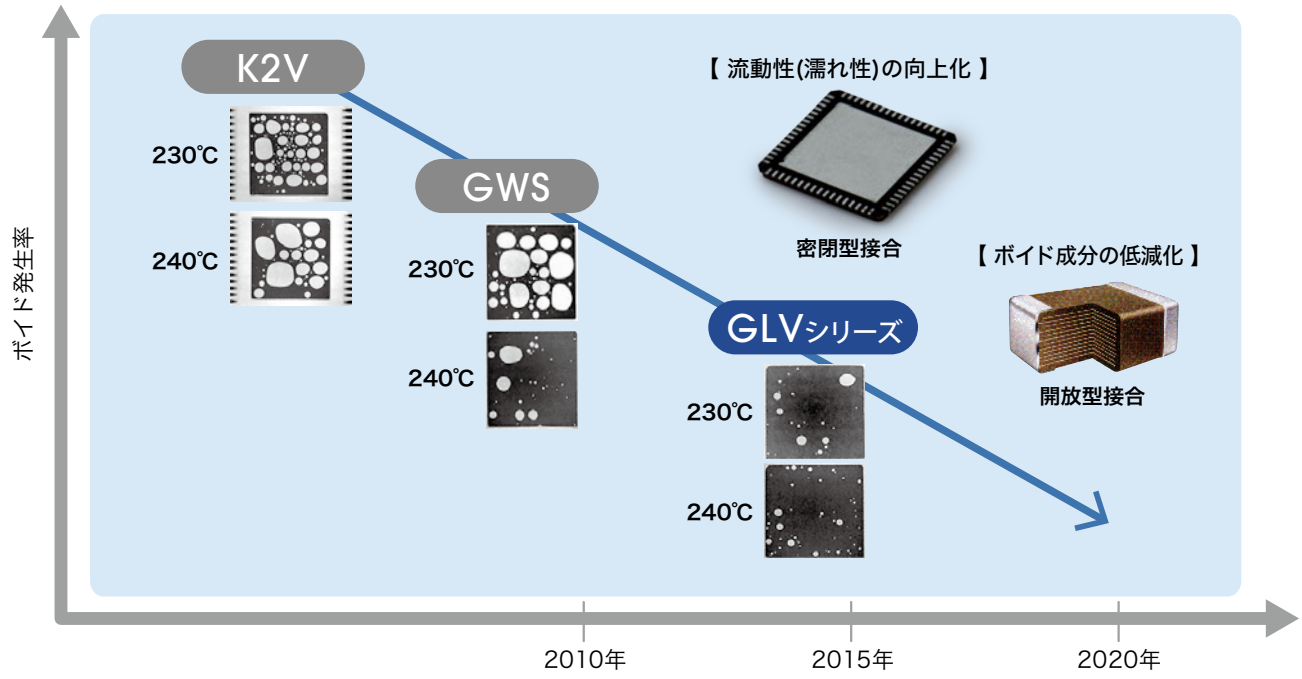
GLVは、ボイドが停留し易い230℃でもボイドを抑制

8mmQFN ボイド面積比率

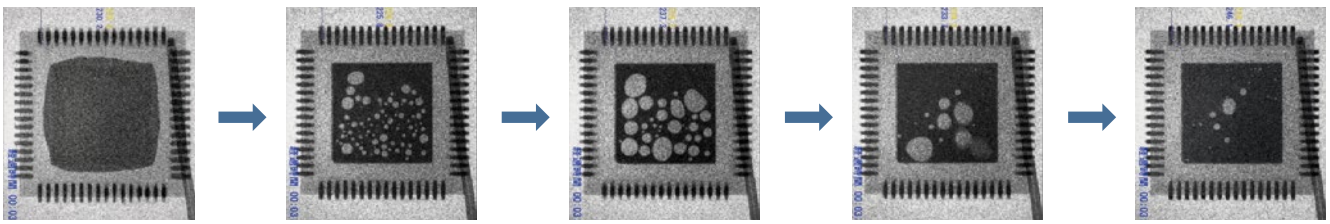


Revolutionary Products

あらゆる部品のボイドを低減する、ソルダペーストGLVシリーズ



● GLVは、良好なはんだ溶融時の流動性で、ボイドを排出



印刷直後　→　ボイド発生　→　ボイド集合　→　ボイド排出　→　凝固

NEP17-07

SMIC